# 薄膜光導波路付カンチレバーチップ先端で発生する近接場のシミュレーション

Simulation of Near Field Generated on the Tip of a Cantilever with Thin-film Optical Waveguide

(株)日立製作所 研究開発グループ<sup>1</sup>, 徳島大学 大学院<sup>2</sup> <sup>0</sup>張 開鋒<sup>1</sup>, 松本 涼太<sup>2</sup>, 山川 市朗<sup>1</sup>, 岡本 敏弘<sup>2</sup>, 原口 雅宣<sup>2</sup>, 谷口 伸一<sup>1</sup> Hitachi, Ltd., R&D Group<sup>1</sup>, Graduate school of Tokushima University<sup>2</sup> <sup>°</sup>Kaifeng Zhang<sup>1</sup>, Ryota Matsumoto<sup>2</sup>, Ichiro Yamakawa<sup>1</sup>, Toshihiro Okamoto<sup>2</sup>, Masanobu Haraguchi<sup>2</sup> and Shin-ichi Taniguchi<sup>1</sup> E-mail: kaifeng.zhang.xg@hitachi.com

### 1. はじめに

近接場走査顕微鏡の空間分解能と測定再現 性の向上をめざし, CNT (Carbon Nanotube)光 プローブと CNT 光プローブに光を導くプラズ モン光導波路を試作し報告してきた<sup>1)-2)</sup>。加え て,光利用効率を向上させ,かつ可視光で計測 するために, FIB により Au コート Si カンチレ バーチップの先端部を削除して,厚さ 250 nm のSi と Au 薄膜から形成された薄膜光導波を有 するカンチレバー (図 1(a))を開発した<sup>34)</sup>。 今回は(1)上記の光導波路構造のシミュレー ションモデルを構築し,カンチレバーチップ先 端で発生する近接場の発生および近接場強度 の励起光入射角依存性の確認および(2)チッ プ先端形状を制御するための重要パラメータ であるチップ正面 Au 膜厚の最適化を実施した。

# 2. モデル

(1)時間領域差分法と有限要素法の2種類 のシミュレータを用いて,励起光の薄膜導波路 への入射過程を含め,薄膜光導波路付カンチレ バー先端の2次元構造モデルを構築した。薄膜 導波路への励起光の入射角θを変化させた。 (2) Au 成膜したチップ先端の形状の詳細を

TEM 像により観察した(図1(b))。得られた形 状情報を参考にして,時間領域差分法のシミュ レータ計算用の3次元構造モデルを構築した (図 1(c))。ここで, Si 先端-Au 先端の距離は チップ正面 Au 膜厚の厚さに相当することを仮 定し, チップ背面の Au 膜厚は 45 nm で固定し た。波長 660 nm と 850 nm の励起光をそれぞれ 所定の入射角で入射させ, チップ先端正面 Au 膜厚を変化させた。

## 3. 計算結果

(1) 2 種類のシミュレーションモデルを用 いて、チップ先端の電界強度分布を計算したと ころ、カンチレバーチップ先端で近接場が発生 することを確認した。薄膜導波路への励起光入 射角度 θ 依存性の計算により、 θ=15.8°(660 nm)と16.2°(850 nm)の時、チップ先端電界 が最大であることを確認した。これらの値は Si/Au/Air 多層構造の反射率の理論計算で得ら れたプラズモン共鳴角とほぼ一致する。(2)図 2 にチップ先端電界強度のチップ正面 Au 膜厚 の依存性を示す。チップ正面の Au 膜厚が 150~160 nm の場合、2 種の励起光波長ともに、 チップ先端の局在電界強度が高くなることか ら、最適膜厚であることがわかった。

#### 文献:

中田他, 第74回応物秋季講演会予稿集, 3, p.113 (2013).
中田他, 第75回応物秋季講演会予稿集, 3, p.486 (2014).
3)張他, 第63回応物春季講演会予稿集, 3, p.112 (2016).
4)張他, 第77回応物秋季講演会予稿集, 3, p.304 (2016).



<sup>(</sup>c) チップ先端のモデルイメージ図



図2 チップ先端電界 E<sub>z</sub>とチップ正面 Au 薄膜の 依存性計算結果